量产烧录 指南

发布版本: 1.2

作者邮箱: <u>liuyi@rock-chips.com</u>

日期: 2019.11

文档密级: 公开资料

前言

概述

本文介绍RK平台的量产烧录方案,包括如何制作烧录镜像、烧录工具使用和常见问题处理。

支持产品

芯片名称	内核版本
RK3326	Linux4.4,Linux4.19
RK3399	Linux4.4,Linux4.19
RK3368	Linux4.4,Linux4.19
RK3288	Linux4.4,Linux4.19
RK3328	Linux4.4,Linux4.19,Linux3.10

读者对象

本文档(本指南)主要适用于以下工程师:

生产技术人员

修订记录

日期	版本	作者	修改说明
2016-07-18	V1.0	刘翊	初稿
2017-02-14	V1.1	刘翊	增加RK3328支持
2019-11-13	V1.2	刘翊	增加Linux4.19支持

量产烧录 指南

- 1. 量产烧录方案
 - 1.1 方案一(USB升级方案)
 - 1.2 方案二(SD升级方案)
 - 1.3 方案三(烧录器升级方案)
- 2. 工具使用
 - 2.1 FactoryTool批量烧录工具
 - 2.2 OemTool(制作Demo镜像工具)
 - 2.3 SD_Firmware_Tool(SD升级卡制作工具)
 - 2.4 SpiImageTool(烧录器镜像制作工具)
- 3. 制作升级固件
 - 3.1 步骤
- 4. 烧录器设置
 - 4.1 EMMC烧录数据:
 - 4.2 EMMC EXT_CSD需要配置的信息:
- 5. 常见升级问题
 - 5.1 下载Boot失败一
 - 5.2 下载Boot失败二
 - 5.3 准备IDB失败
 - 5.4 下载IDB失败
 - 5.5 下载固件失败

1. 量产烧录方案

1.1 方案一(USB升级方案)

步骤1:制作update.img升级固件

步骤2:使用FactoryTool进行批量烧录

1.2 方案二(SD升级方案)

步骤1: 制作update.img升级固件

步骤2: 使用SD_Firmware_Tool工具制作固件升级的SD卡

步骤3: 插入升级SD卡, 重新上电, 进行固件烧录

1.3 方案三(烧录器升级方案)

步骤1: 制作update.img升级固件

步骤2: 使用SpiImageTool工具制作烧录器的烧录文件

步骤3: 存储芯片接入烧录器, 进行固件烧录

2. 工具使用

2.1 FactoryTool批量烧录工具



使用步骤:

点击"固件",选择升级固件

如果有烧录Demo镜像,则勾选"Demo"选择Demo镜像(可选),Demo镜像制作见OemTool工具使用点击"启动",开始自动检测升级设备

连接升级设备, 工具检测到后, 自动开始升级

2.2 OemTool(制作Demo镜像工具)



制作Demo镜像步骤:

- 1. 点击"选择…", 选择制作镜像的Demo目录
- 2. 勾选"Fat32",目前只支持Fat32格式镜像
- 3. 设置"磁盘大小",只要大于user分区的容量,按100M对齐即可
- 4. 点击"开始执行",成功后会在工具目录下生成一个OemImage.img镜像文件

2.3 SD_Firmware_Tool(SD升级卡制作工具)

♣ 瑞芯微仓	建升级磁盘工具 v1.46		X
第一步	: 选择可移动磁盘设备 NORELSYS 1081 USB Device	29.1G ▼	SDBoot:2.12
第二步	····································	PCBA测试	SD启动
第三步	:选择升级固件		
第四步	:选择Demo数据(可选)		选择固件
			选择Demo
			开始创建
			恢复磁盘

SD升级卡制作步骤:

- 1. 从下拉列表中,选中要制作的SD卡或U盘
- 2. 勾选"固件升级"
- 3. 点击"选择固件",选择update.img升级固件
- 4. 点击"开始创建"

2.4 SpiImageTool(烧录器镜像制作工具)



烧录器镜像制作步骤:

- 1. 点击"选择固件",选取update.img升级固件
- 2. 存储使用Emmc时, 勾选"数据区预留"

- 3. 存储使用Emmc时,空白填充选择0,存储使用nandflash时,空白填充选择0xFF
- 4. 点击"生成文件",成功时会在工具目录下生成boot0.bin和data.bin。emmc情况只使用data.bin,nandflash情况需要使用boot0.bin和data.bin

3. 制作升级固件

3.1 步骤

- 1. 在Android源代码目录下,运行mkimage.sh脚本带上ota参数,生成system.img、boot.img和 recovery.img等,将其拷贝到rockdev的image目录下。
- 2. 在AndroidTool的rockdev目录下,执行mkupdate.bat批处理,生成update.img升级固件.ubuntu下执行mkupdate.sh脚本生成。下图为mkupdate.bat内容:

```
2 Afptool -pack ./ Image\update.img
3
4
5 RKImageMaker.exe -RK31 RK3188Loader(L)_V2.10.bin Image\update.img update.img -os_type:androidos
```

重点关注-RK31这个参数,它需要跟设备匹配。如果不清楚这个值,可以通过下面方法获得:

• 打开androidtool工具,进入高级功能,选择这个方案的loader文件,点击"下载"



• 点击下方的"读取Chip信息",右方会打印出以下信息,Image Chip Flag就是那个参数

获取ChipInfo开始 Chip Tag: 33 33 30 43 Image Chip Flag: -RK330C 获取ChipInfo成功

4. 烧录器设置

4.1 EMMC烧录数据:

EMMC分为3个部分,USER区,BOOT1区和BOOT2,只需要烧录USER分区即可,烧录的文件为SpiImageTool生成的data.bin。

4.2 EMMC EXT_CSD需要配置的信息:

```
EXT_CSD[167] = 0x1f (如果芯片支持,需要配置)

EXT_CSD[162] = 0x0 (默认值)

EXT_CSD[177] = 0x0 (默认值)

EXT_CSD[178] = 0x0 (默认值)

EXT_CSD[179] = 0x0 (默认值)
```

5. 常见升级问题

5.1 下载Boot失败一

ID	失败	设备列表	设备类型	ID	升級信息
20	下载Boot失败	□ ・			
		RootHub20			
		Port[1]	Hub	4	
		Port[1]			
		⊷ Port[4]			
		——————————————————————————————————————	Maskrom	20	下载Boot失败

日志提示:

08:58:34 722	Layer<20, 2-1-6>:下载Boot开始
08:59:41 498	<pre><layer 2-1-6=""> ERROR:Boot_VendorRequest>DeviceIoControl failed, Total (45058), Sended(0), I</layer></pre>
08:59:41 499	<layer 2-1-6=""> ERROR:DownloadBoot>Boot_VendorRequest471 failed,index(0)</layer>
08:59:41 502	[Brror] Layer<20,2-1-6>:下载Boot失败

可能的原因:

- 1. USB信号不好(检查usb线路上的电容和电阻参数是否正常,usb供电是否正常)
- 2. 主控虚焊或者电源供电问题

5.2 下载Boot失败二



可能的原因:

DDR颗粒或者走线问题

5.3 准备IDB失败



09:13:28 244 Layer<20,2-1-6>:准备IDB开始

可能的原因:

Flash虚焊或者不支持的颗粒

5.4 下载**IDB**失败



可能的原因:

- 1. USB通讯问题(断电重试,需要使用有源usb hub)
- 2. DDR稳定性问题(使用DDR测试工具进行稳定性测试)

5.5 下载固件失败



可能的原因:

- 1. USB通讯问题(断电重试,需要使用有源usb hub)
- 2. Flash问题(使用AndroidTool擦除flash重试)